

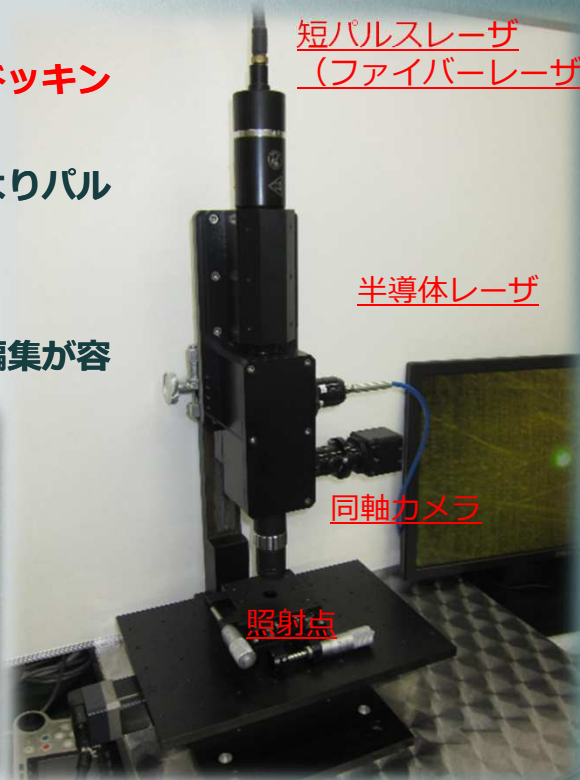
# 微細加工用ハイブリッド 短パルスレーザーユニット

## ▶ 特徴)

- ▶ **ファイバーレーザーと半導体レーザーを同軸上でドッキング**、更にモニター上で**照射点の確認**が可能
- ▶ 半導体レーザーで**加工点を予め予熱**することによりパルスレーザーでの**加工効率を向上**（スパッタ低減）
- ▶ 同軸モニター上で加工点を確認
- ▶ 専用ソフトで各レーザーの**タイミングチャート編集が容易**

同軸カメラでの照射点

緑色部：半導体レーザーガイド光（緑） $\phi 50\mu\text{m}$   
中央部：パルスレーザー加工痕 $\phi 20\mu\text{m}$

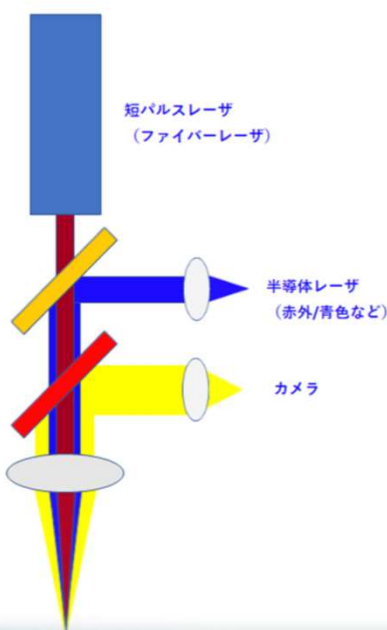


## ▶ 用途)

- ▶ レーザ微細溶接  
溶着、切断など

## ▶ 構成例)

ハイブリッドレーザー  
構成例



## ▶ 主な仕様例)

### ▶ レーザ1

青色及び赤外半導体レーザー

- ・ファイバー：コア径 $\phi 100\sim 400\mu\text{m}$
- ・出力：20~100W

### ▶ レーザ2

- ・ファイバーレーザー（1064nm）
- ・パルス幅：100ns
- ・周波数：50-200kHz

### ▶ 同軸観察系

- ・CCD/CMOSカメラ
- ・倍率： $\times 100\sim 1000$